PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

04178920 A

(43) Date of publication of application: 25 . 06 . 92

(51) Int. Cl	G11B 5/84		
(21) Application n	umber: 02306814	(71) Applicant:	HITACHI ELECTRON ENG CO LTD
(22) Date of filing	: 13 . 11 . 90	(72) Inventor:	ISHIMORI HIDEO Nakakita takashi

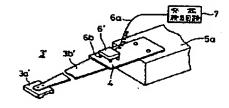
(54) PROTRUSION DETECTION HEAD ASSEMBLY

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a protrusion signal with an improved sensitivity by mounting a piezo element with the natural frequency which is equal to that of a gimbal bar to a support arm.

CONSTITUTION: A ceramic core 3a' vibrates due to collision of a magnetic disk and a protrusion and the natural vibration of a frequency fO of a gimbal bar 3b' which is generated by the vibration of the ceramic core 3a' is transmit ted to a piezo element 6' of the natural frequency fO which is mounted to a support arm 4 elastically. Then, regardless of an extremely low natural fre quency of the support arm 4 due to rigidity, the piezo element 6' resonates being induced by the natural vibration of the gimbal bar 3b' due to mutual resonance operation and then a protrusion signal with a sufficient strength is output from a protrusion detection circuit 7, thus obtaining a protrusion signal with an improved sensitivity.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio



THIS PAGE BLANK (USPTO)

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

② 公開特許公報(A) 平4−178920

®Int. Cl. ⁵

識別配号 广内整理番号

@公開 平成4年(1992)6月25日

G 11 B 5/84

C 7177-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

分発明の名称 突起検出ヘッドアッセンブリ

②特 願 平2-306814

❷出 願 平2(1990)11月13日

⑫発 明 者 石 森 英 男 東京都千代田区大手町2丁目6番2号 日立電子エンジニ

アリング株式会社内

⑫発 明 者 中 北 俊 東京都千代田区大手町2丁目6番2号 日立電子エンジニ

アリング株式会社内

⑦出 願 人 日立電子エンジニアリ 東京都千代田区大手町2丁目6番2号

ング株式会社

⑩代 理 人 弁理士 梶山 佶是 外1名

明細掛

1.発明の名称 突起検出ペッドアッセンブリ 2.特許讃求の範囲

3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は、磁気ディスクの突起検査装置に使用する突起検出へッドアッセンブリに関する。

【従来の技術】

情報処理装蔵に使用されるハード磁気ディスクはアルミニュームディスクをベースとし、その表面に維性膜を塗布、スパッタリング等により形成する。確性膜は凹凸がない平滑な力をで、このために研解が行われる。ただし研解によってもなお突起が残留することがあり、突起が残留すると磁気へッドが衝突して損傷し、またがある。これを避けるために研密につづいて突起検査を行い、その結果により再研磨を行うか、または研密が終了する。

第2図(a) は磁気ディスク突起検査装置の機製を、図(b) は従来の突起検出アッセンブリを、図(c) は突起信号の放形をそれぞれ示す。図(a) において、被検査の磁気ディスク1はスピンドル2に装着されて回転する。一方、ヘッドアッセンブリ3は、セラミック、金属等のヘッドコア3a がソンバルパー3b の先端に取り付けられたもので、ヘッドコア3a の適当な位置にピエゾ案子6を掲



特開平 4-178920(2)

121

最近においては磁気ディスクの小型化と記録密度の高度化が進み、また磁気ペッドとしてはセラミックスのコアを使用した超小型軽量の薄膜ペッドが出現している。これに対応して実起検査においても、ペッドコアとして薄膜ペッドのセラミックコアを使用することが必要とされている。しかし、セラミックコアは超小型であるため、これに

ピエソ素子 8 を取り付けることは困難であり、またジンパルパーも小型化されているので同様に困難である。 そこで、ピエソ素子 8 は余値なく支持アーム 4 に取り付けられている。

[解決しようとする課題]

するので、突起信号は散弱となって突起が満足に 検出されないことが判明した。以上に対して有効 な対策を講ずることが必要とされている。

ここで、上記の実起検出ヘッドアッセンブリの 編動系はやや複雑であるが、これを単純化して第 3図(b) に示す振動系モデルを考える。いま、ジ ンパルパー3b′を撮動車S」とし、その間有板 動数をlo とする。支持アーム4を固有振動数が 非常に低い弾性体Mとし、これにジンパルパー3 b ' が弾性的に結合されているとする。一方、ピ ,エソ案子Bを被擬動体S2とし、これが支持アー ム4にやはり弾性的に結合されているとする。い は、被脳動体S2の固有振動数が、振動順S1の 固有緩動数 10 に等しいときは、弾性体Mの非常 に低い固有振動数に拘らず、振動器Siの固有振 動に誘因されて被擬動体S2が固有振動数fDで 共振することが経験的に知られている。このよう な、編動観81と被振動体82の相互の共振作用 を利用することにより、十分な強度の実起信号を うることができる筈である。

この党明は、以上の相互共振現象を利用して、 以好な感度で突起信号をうることができる実起検 出アッセンブリを提供することを目的とするもの である。

[課期を解決するための手段]

[作用]

以上の構成による突起検出ヘッドアッセンブリ

においては、突起との衝突により突起検出へッド に発生する振動は、突起検出へッドが固定されて いるジンパルパーに伝達され、ジンパルパーは自 己の固有振動数で振動する。これに対して、支持 アームに弾性的に取り付けられているピエゾ素子 は、 グンパルパーに等しい固有振動数を有するの で、 女持アームの非常に低い固有振動数に拘らず、 前記した相互共振作用により、 ジンパルパーの固 有振動に誘因されてピエゾ素子が共振し、 十分な 強度の突起信号がえられるものである。

[実施例]

第1図は、この発明による突起検出へッドアッセンブリの実施例を示す。突起検出へッドとして例えば、薄膜ヘッドのセラミックコア 3 a ' と、これを先端に固定した小型化されたジンパルパー3b' とによりヘッドアッセンブリ3' が構成される。ジンパルパー3b' は軽積であるので、その共振関放数fo はかなり高く、例えば数k H 2 以上である。ジンパルパー3b' の他端は従来と同様に支持アーム4に取り付けられる。支持アー

ム4は関性の強い弾性体で、その固有振動数はかなり低いものとし、従来と同様に、キャリッジ機構の移動部5aに片持ち葉式に固定されている。支持アーム4の関示の位置に、適当な弾性を有する例えば、がなどの支持機6bを用いて支持するしまってはゴム材などの支持機6bを弾性的に支持する。ピエン案子6、を弾性的に支持で見いている。ピエン案子6、は接続限8aにより突起検出回路7に接続される。なお、数kH2の固行振動数f0を何するピエンボ子6、は容易に製作することができる。

が共振し、十分な強度の突起信号が突起検出回路 7より出力される。

[発明の効果]

以上の説明により明らかなように、この発明による突起検出アッセンブリにおいては、突起検出へッドの振動により生ずるジンパルパーの固有振動は、支持アームに弾性的に取り付けられたピェン素子に伝達され、これに誘因されてジンパルパーに等しい固有振動数を有するピエン素子が共振し、上分な強度の磁気ディスクに対して信頼性の高い突起検査を可能とする効果には大きいものがある。

4.図面の簡単な説明

第1図は、この発明による突起検出へッドアッセンブリの実施例における科視外観図、第2図(a)は磁気ディスク突起検査装蔵の概要図、第2図(b)は従来の突起検出アッセンブリの外観閲、第2図(c)は突起信号の被形図、第3図(a)は、薄膜へッドのセラミックコアを実起検出ヘッドとす

る突起検出ヘッドアッセンブリの外観関、第3関 (b) は、第3関(a) の突起検出アッセンブリに対 する振動系モアル図である。

1…磁気ディスク、 2…スピンドル、

3. 3' …ヘッドアッセンブリ、

3a …金属のヘッドコア、3a ′ …セラミックコア、3b,3b ′ …ダンバルパー、4…支持アーム、

5…キャリッジ機構、 5a…移動部、

5 6 …取動モータ、 5 6 …ねじ得、

B , 6 ′ …ピエゾ素子、 B a …接続線、

61 …支持棒、

7…突起快出回路。

特許出面人

日立電子エンジニアリング株式会社

代理人 弁理上 掘 山 佶 及 弁理士 山 本 富士男

特開平 4-178920 (4)

